



株式会社メイコー

(証券No.6787)

2013年3月期 決算説明会

2013年5月21日

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績見通し等の計画・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの見通しは過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成した見通しです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は見通しと異なる場合がございます。

目次

I. 2012年度実績報告

1. 2012年度のまとめ	...4
2. 2012年度連結決算	...5
3. 2012年度海外工場決算	...6
4. 2012年度期首計画未達要因分解	...7
5. 営業利益推移要因分析	...8
6. 売上高(基板品目別)	...9
7. 売上高(基板アプリケーション別)	...10
8. 売上高(工場別)	...11
9. 売上高(顧客国籍別)	...12
10. 設備投資額 実績推移	...13

II. 2013年度見通し報告

1. 2013年度連結見通し	...15
2. 営業利益推移要因分析	...16
3. 売上高過年度推移並びに見通し(基板品目別)	...17
4. 売上高過年度推移並びに見通し (基板アプリケーション別)	...18
5. 売上高過年度推移並びに見通し(工場別)	...19
6. 売上高過年度推移並びに見通し(顧客国籍別)	...20
7. 基板市場別売上変動要因分析	...21
8. 2013年度 経営方針	...22
9. 広州工場 重点施策並びに見通し	...23
10. 武漢工場 重点施策並びに見通し	...24
11. 越南工場 重点施策並びに見通し	...25
12. 石巻工場	...26

III. 技術戦略

1. 技術戦略	...28
2. 技術資料(MDiM)	...29
3. 技術資料(部品内蔵基板)	...31
4. 技術資料(新FR基板)	...33
5. 技術資料(新放熱基板)	...34

I . 2012年度実績



1. 2012年度のまとめ

■ 売上高

当初計画より113億円下方の607億円に留まった。

■ 中国工場

米国スマートフォン向け基板の受注が不調だった。

日系TV向け基板市場の縮小が想定以上に加速した。

中国反日活動により受注低迷・生産ダウン・労務費上昇が起きた。

■ ベトナム工場

アジア企業スマートフォン向けHDI基板を中心に量産を開始したが、投資削減の為当初計画よりも立上が遅れた。

2. 2012年度 連結決算

単位:百万円

	2011年度	前年比	2012年度	前年比
売上高	62,972	-15.7%	60,709	-3.6%
営業利益	812	-75.4%	-605	-
営業利益率	1.3%		-1.0%	
経常利益	222	-89.6%	-386	-
経常利益率	0.4%		-0.6%	
当期純利益	1,158	-	-1,567	-
当期純利益率	1.8%		-2.6%	
1株当たり当期純利益	61.73円	-	-83.52円	-

レート 1USD=78.96JPY

1USD=83.31JPY

3. 2012年度 海外工場決算

■ 広州工場

単位:百万円

	2011年度実績	前年比	2012年度実績	前年比
売上高	28,383	-8.8%	27,661	-2.5%
営業利益	960	-26.7%	1,570	63.5%
営業利益率	3.4%		5.7%	

レート 1USD=78.96JPY 1USD=83.31JPY

■ 武漢工場

	2011年度実績	前年比	2012年度実績	前年比
売上高	19,024	-26.3%	17,665	-7.1%
営業利益	-548	-	-2,638	-381.4%
営業利益率	-2.9%		-14.9%	

レート 1USD=78.96JPY 1USD=83.31JPY

■ 越南工場

	2011年度実績	前年比	2012年度実績	前年比
売上高	839	-	3,390	304.1%
営業利益	-757	-	-1,461	-93.0%
営業利益率	-90.2%		-43.1%	

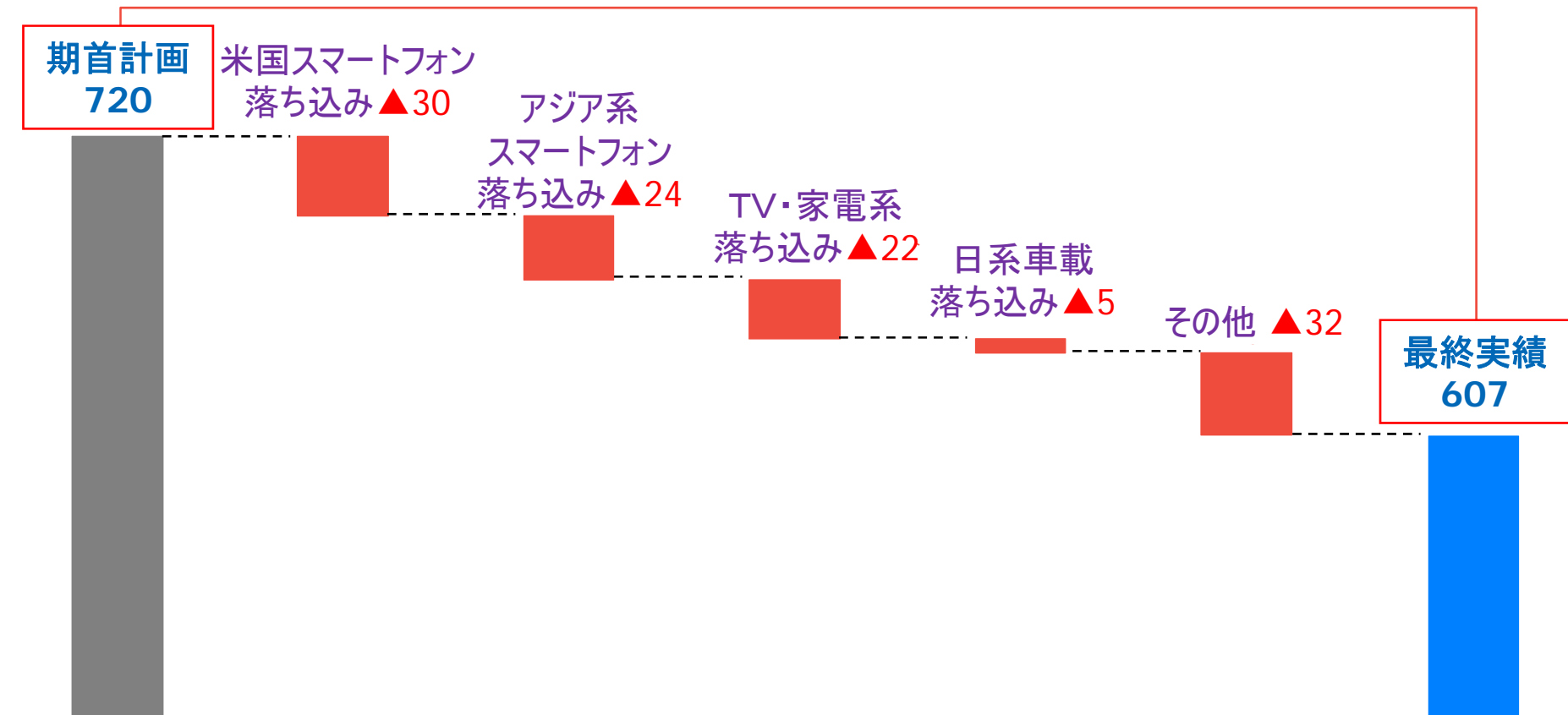
レート 1USD=78.96JPY 1USD=83.31JPY

基板事業以外は除く。ただし、基板設計・製造ツール・半製品を含む。

4. 2012年度 期首計画未達要因分解

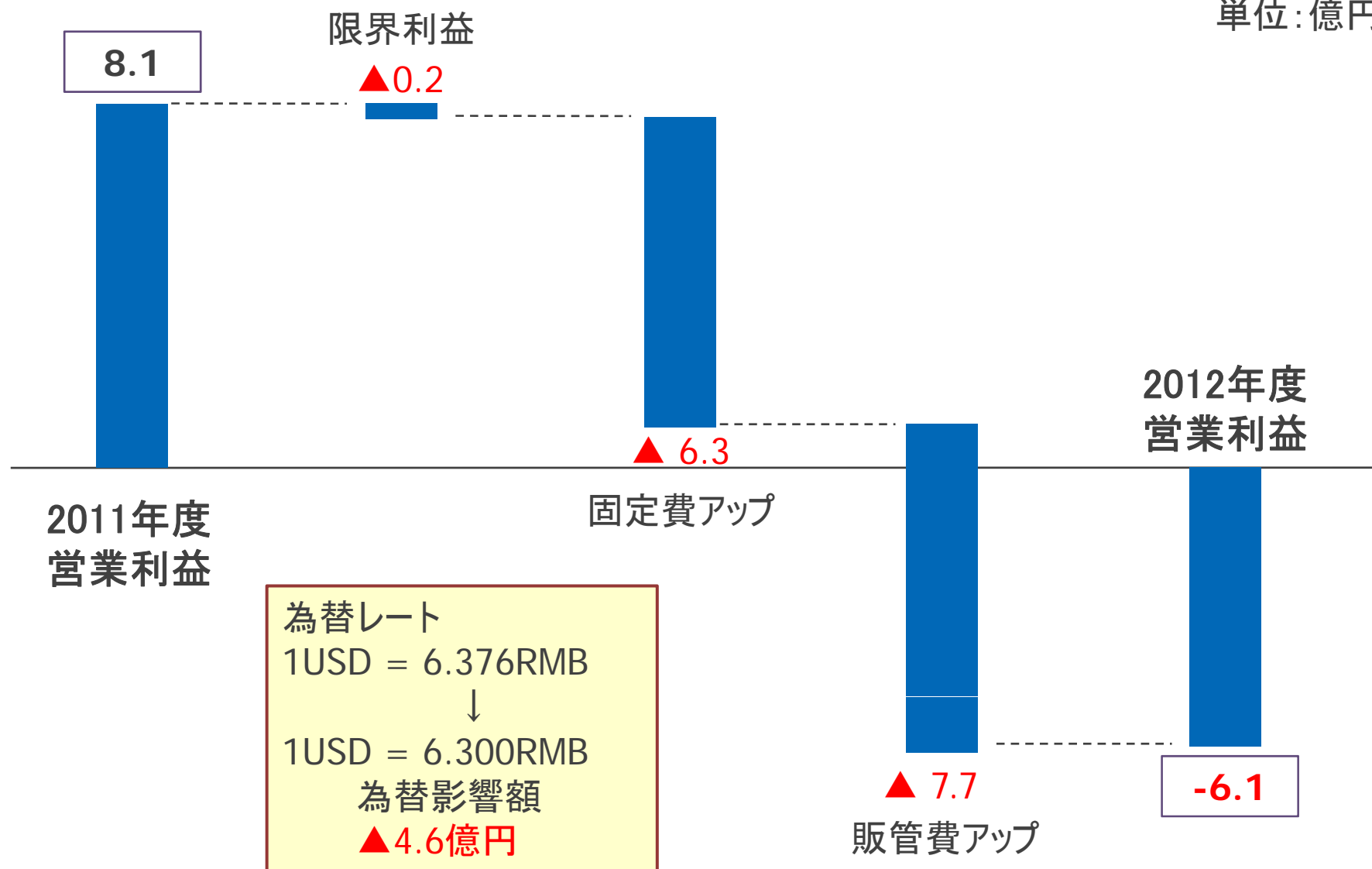
単位: 億円

▲113億円



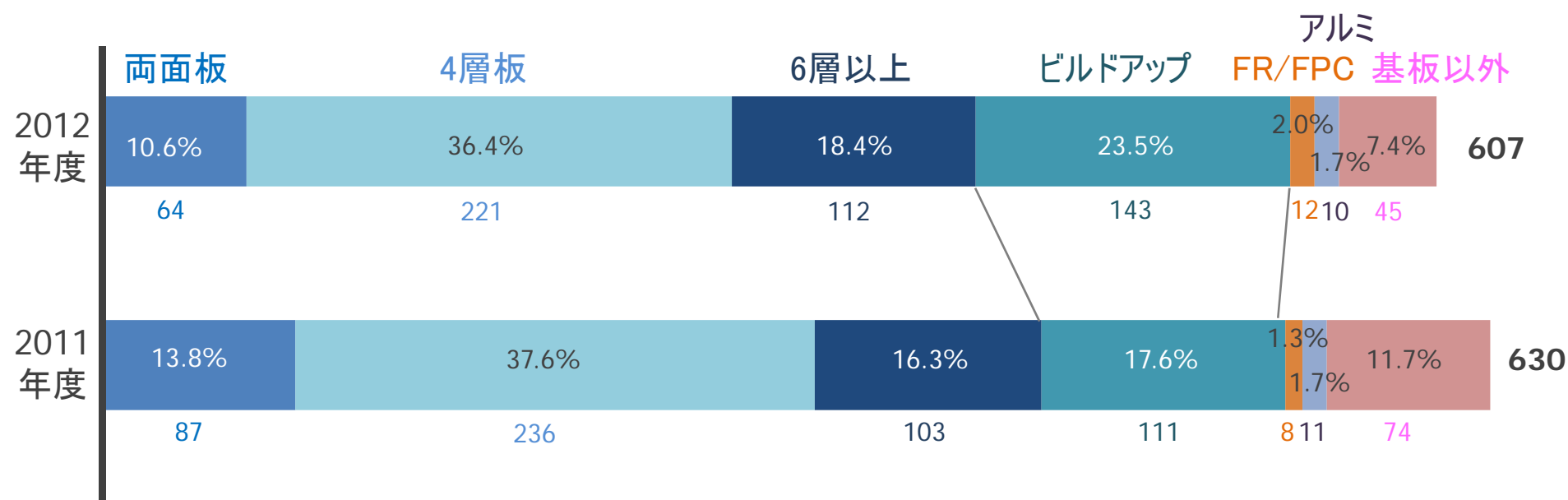
5. 2012年度 営業利益推移要因分析

単位: 億円



6. 2012年度 売上高(基板品目別)

単位:億円

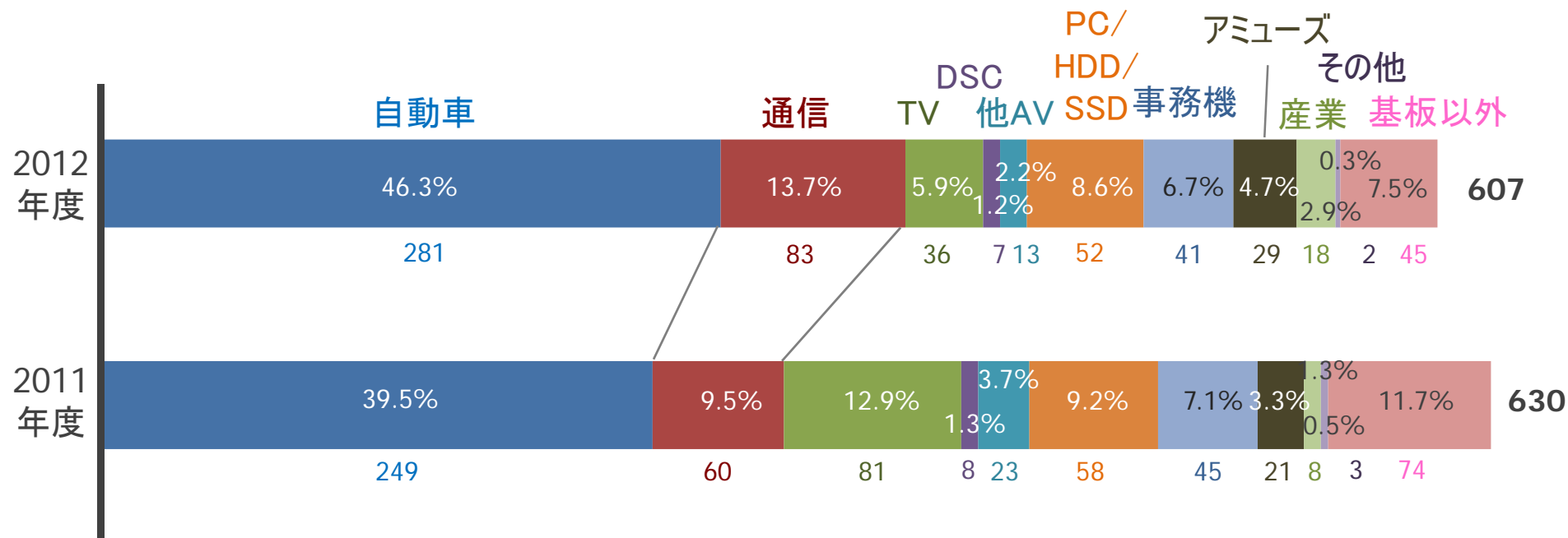


2012年度 1USD = 83.31JPY

2011年度 1USD = 78.98JPY

7. 2012年度 売上高(基板アプリケーション別)

単位:億円

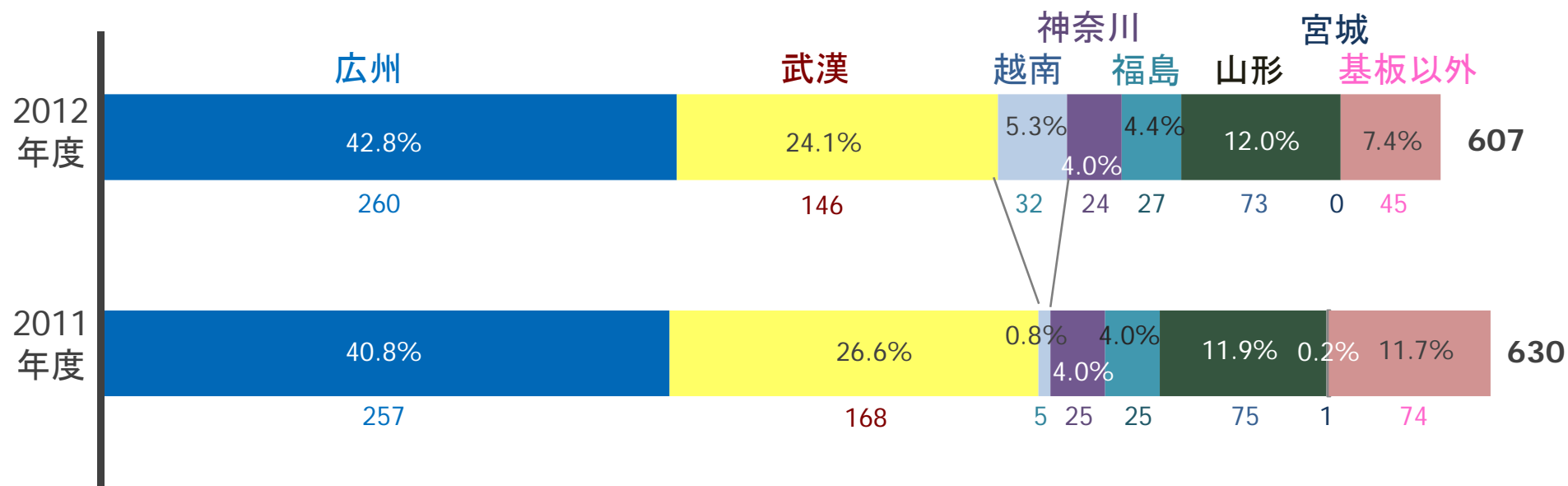


2012年度 1USD = 83.31JPY

2011年度 1USD = 78.98JPY

8. 2012年度 売上高(工場別)

単位:億円



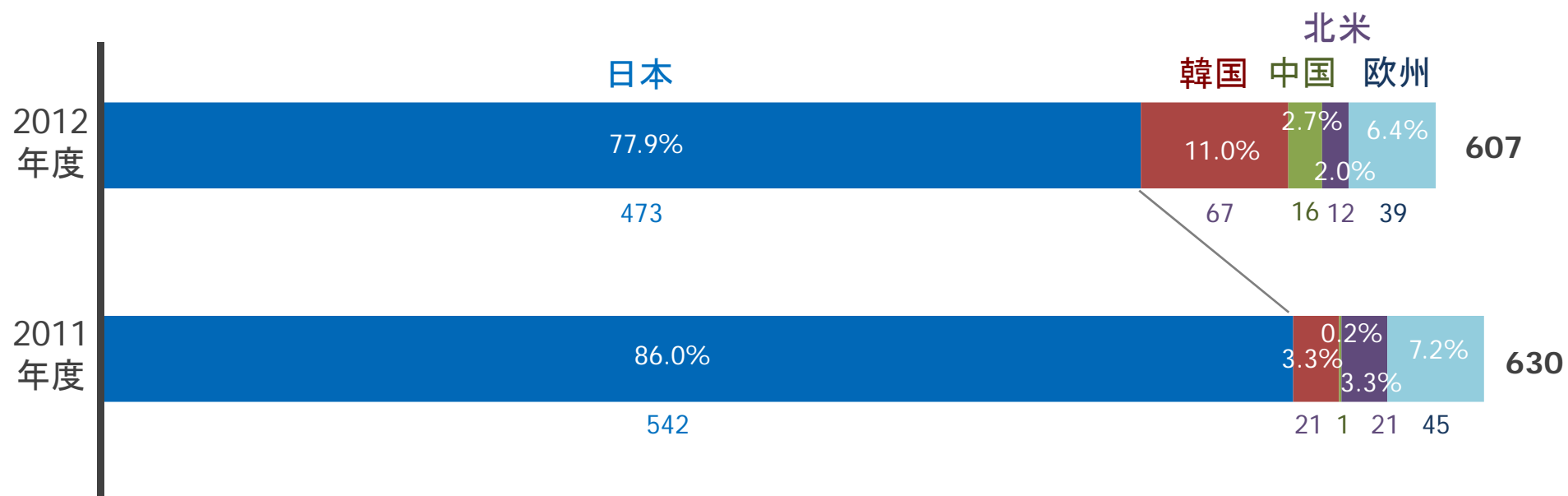
2012年度 1USD = 83.31JPY

2011年度 1USD = 78.98JPY

※基板のみの売上であり、基板設計・製造ツール・半製品は含まない。

9. 2012年度 売上高(顧客国籍別)

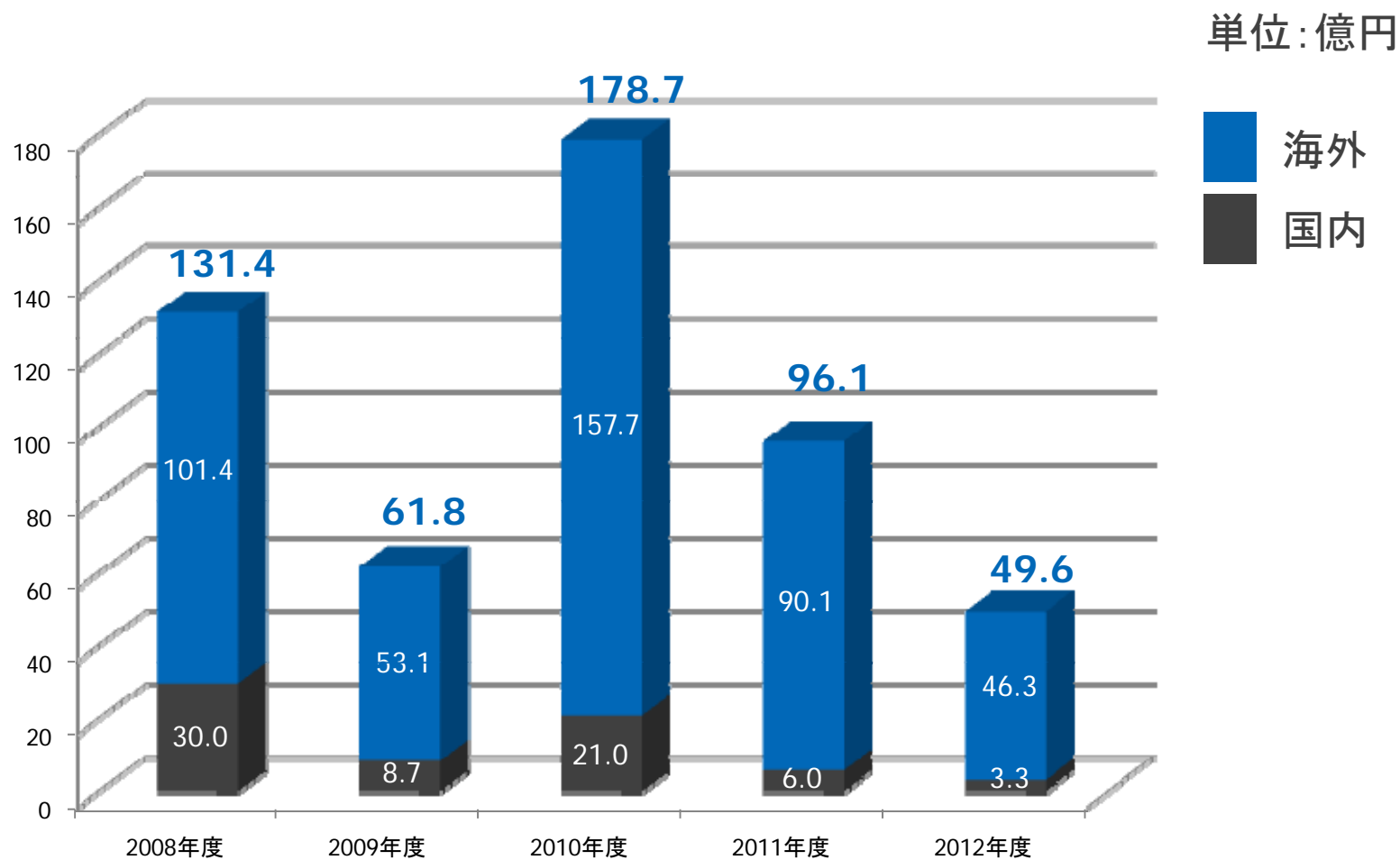
単位:億円



2012年度 1USD = 83.31JPY

2011年度 1USD = 78.98JPY

10. 設備投資額 実績推移



※数値は検収ベース

Ⅱ. 2013年度見通し



1. 2013年度 連結見通し

単位:百万円

	2012年度		2013年度					
	実績	売上比	上期		下期		通期	
			計画	売上比	計画	売上比	計画	売上比
売上高	60,709	-	37,600	-	39,400	-	77,000	-
営業利益	(605)	-1.0%	1,500	4.0%	2,200	5.6%	3,700	4.8%
経常利益	(386)	-0.6%	950	2.5%	1,750	4.4%	2,700	3.5%
当期純利益	(1,567)	-2.6%	200	0.5%	800	2.0%	1,000	1.3%
減価償却費	6,282	-	3,009	-	3,143	-	6,152	-
EBITDA	5,677	9.4%	4,509	12.0%	5,343	13.6%	9,852	12.8%
設備投資	4,960	-	3,590	-	430	-	4,020	-

※設備投資数値は検収ベース

2012年度為替レート 1USD=83.31JPY

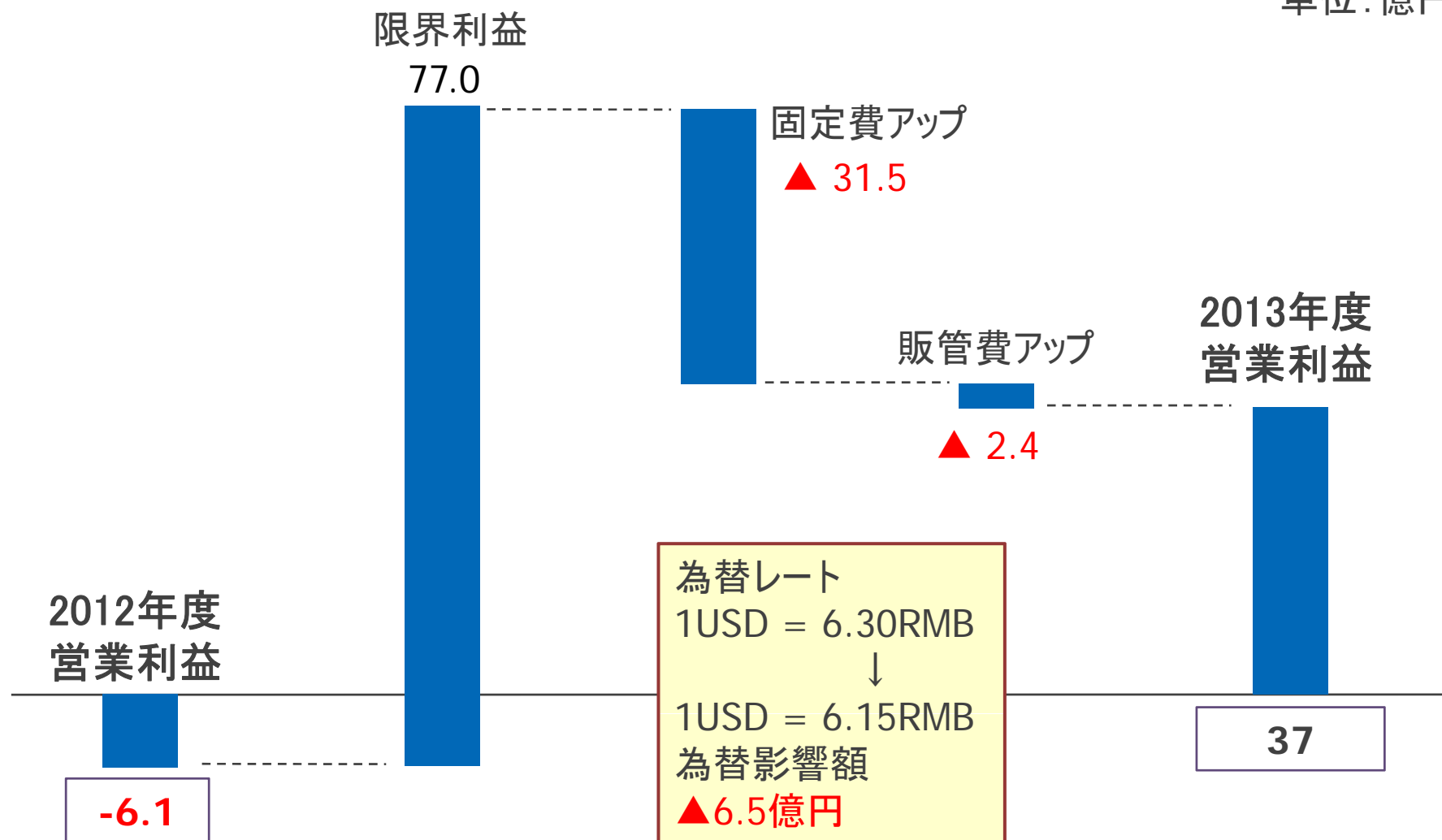


2013年度為替レート 1USD=95.00JPY

中期計画は、上期実績を見極め
11月に公表いたします。

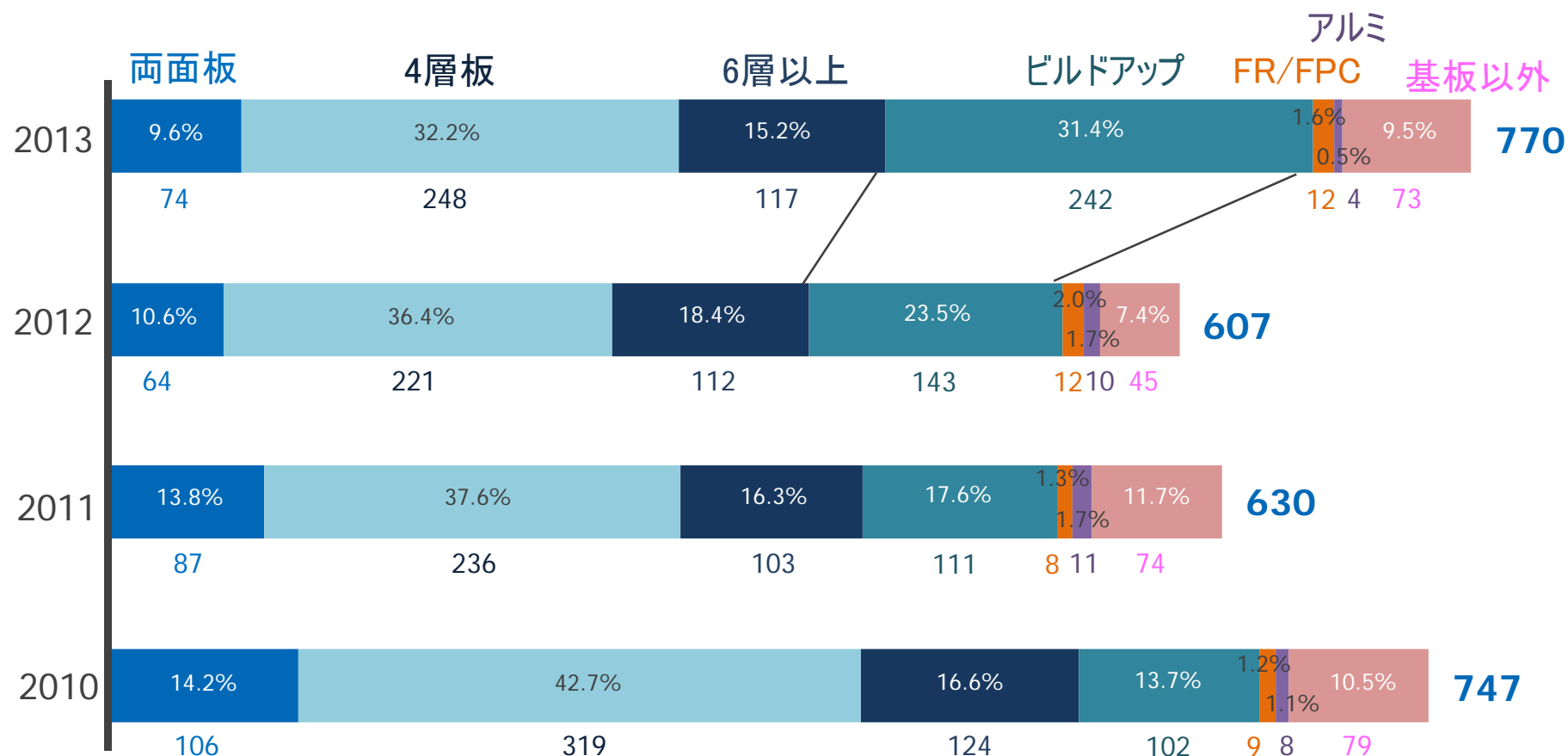
2. 2013年度 営業利益見通し要因分析

単位: 億円



3. 売上高 過年度推移並びに見通し(基板品目別)

単位:億円

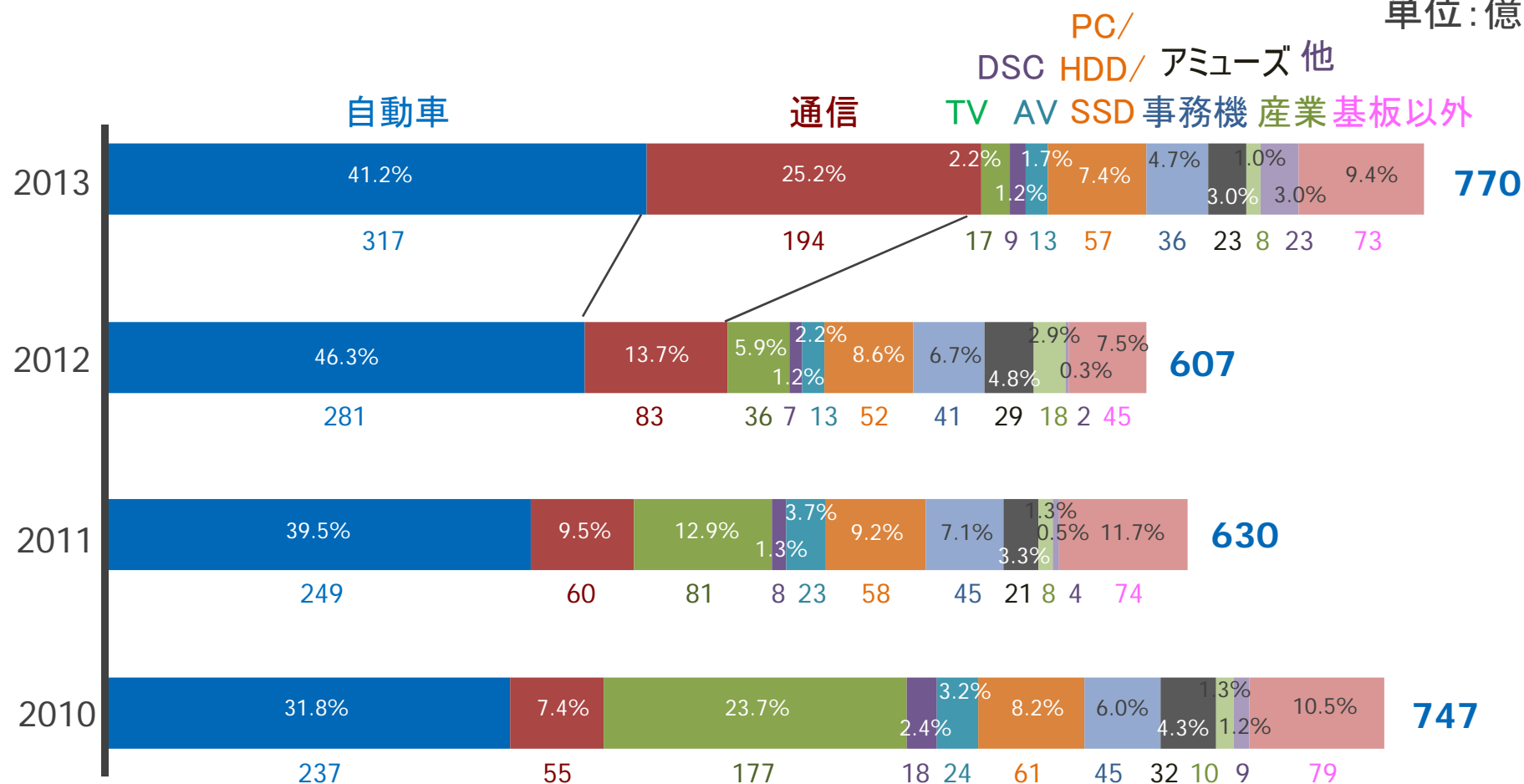


2013年度 1USD = 95.00JPY 2012年度 1USD = 83.31JPY

2011年度 1USD = 78.98JPY 2010年度 1USD = 85.22JPY

4. 売上高 過年度推移並びに見通し(基板アプリケーション別)

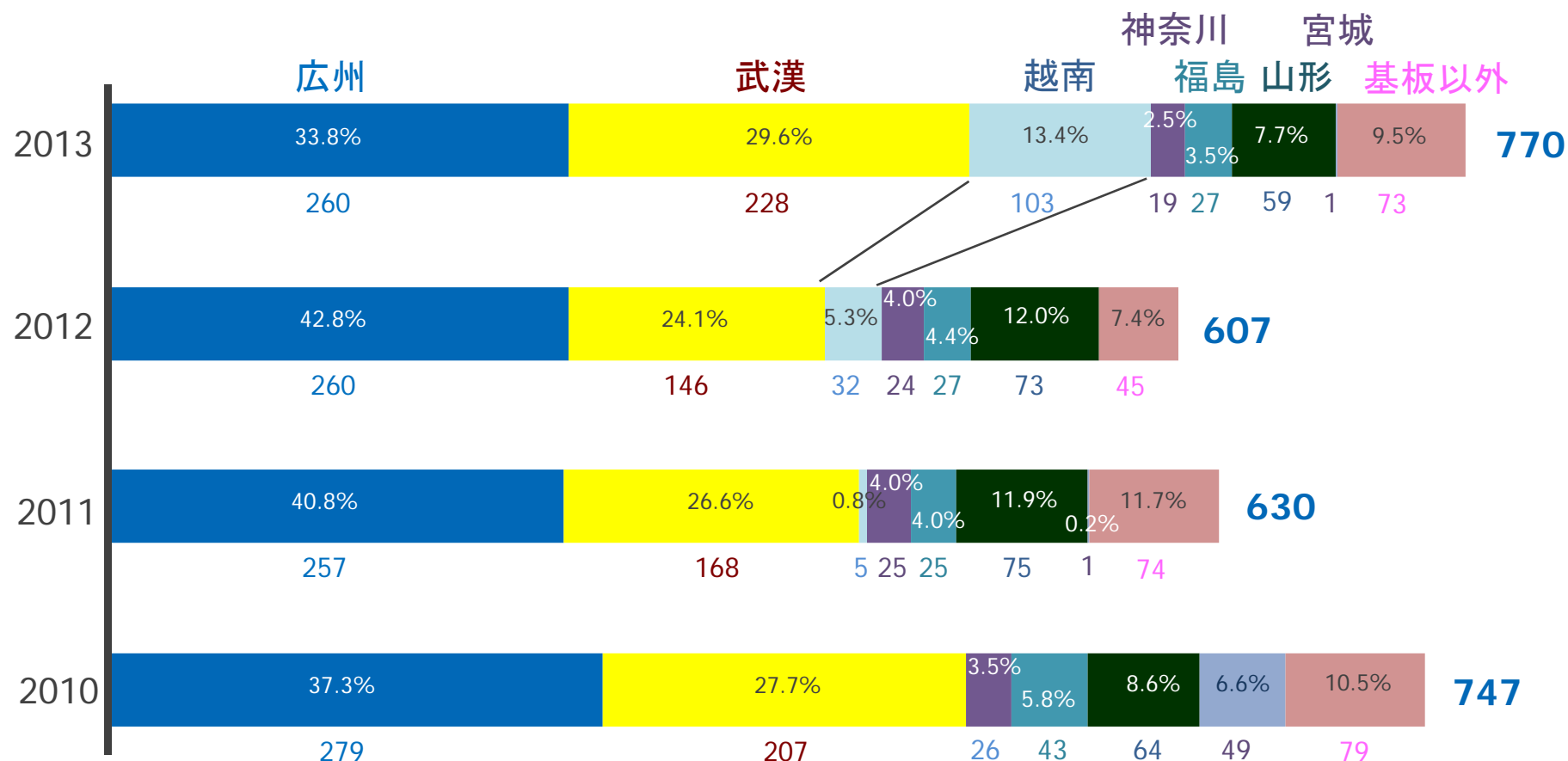
単位:億円



2013年度 1USD = 95.00JPY 2012年度 1USD = 83.31JPY
 2011年度 1USD = 78.98JPY 2010年度 1USD = 85.22JPY

5. 売上高 過年度推移並びに見通し(工場別)

単位:億円



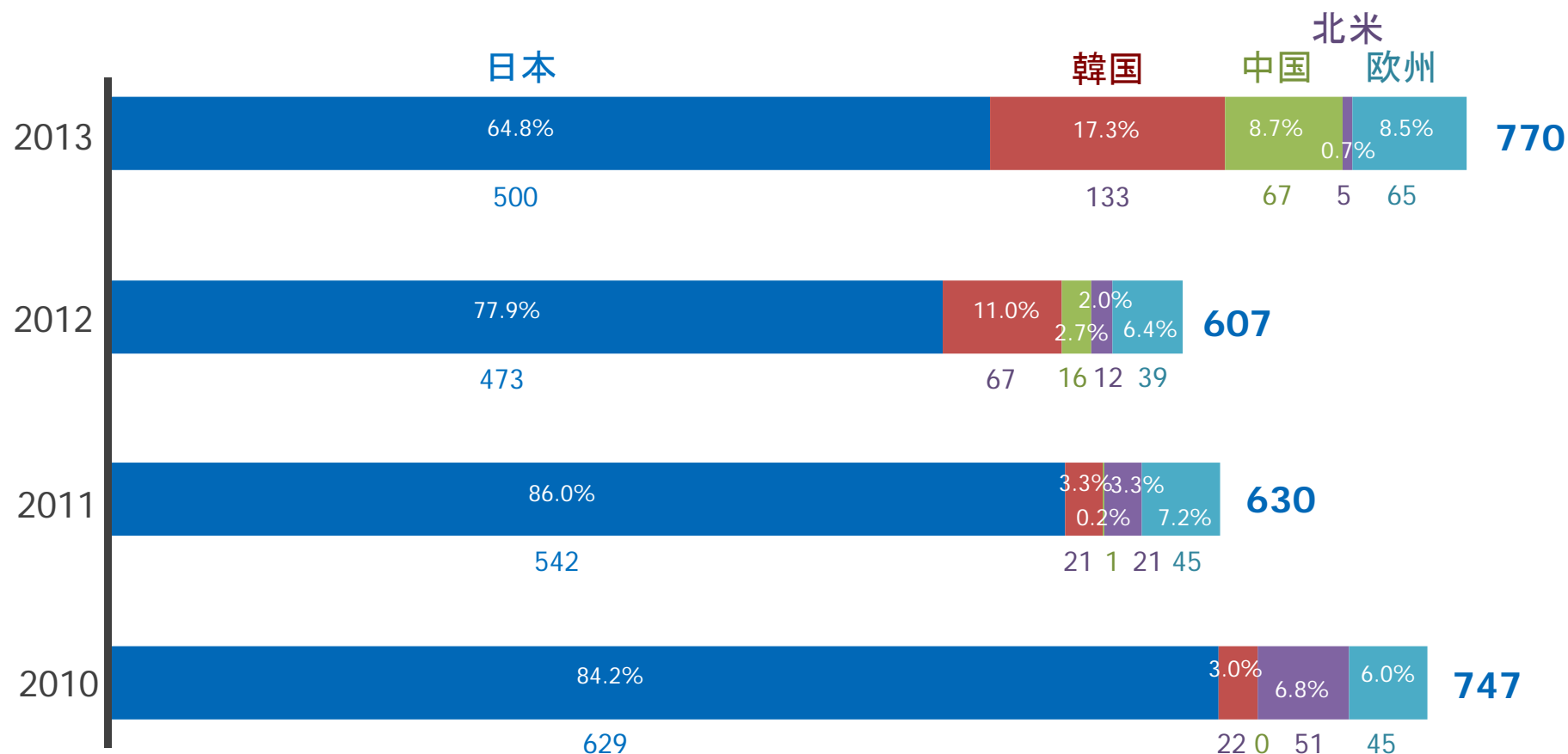
※基板のみの売上であり、基板設計・製造ツール・半製品は含まない。

2013年度 1USD = 95.00JPY 2012年度 1USD = 83.31JPY

2011年度 1USD = 78.98JPY 2010年度 1USD = 85.22JPY

6. 売上高 過年度推移並びに見通し(顧客国籍別)

単位:億円



2013年度 1USD = 95.00JPY 2012年度 1USD = 83.31JPY

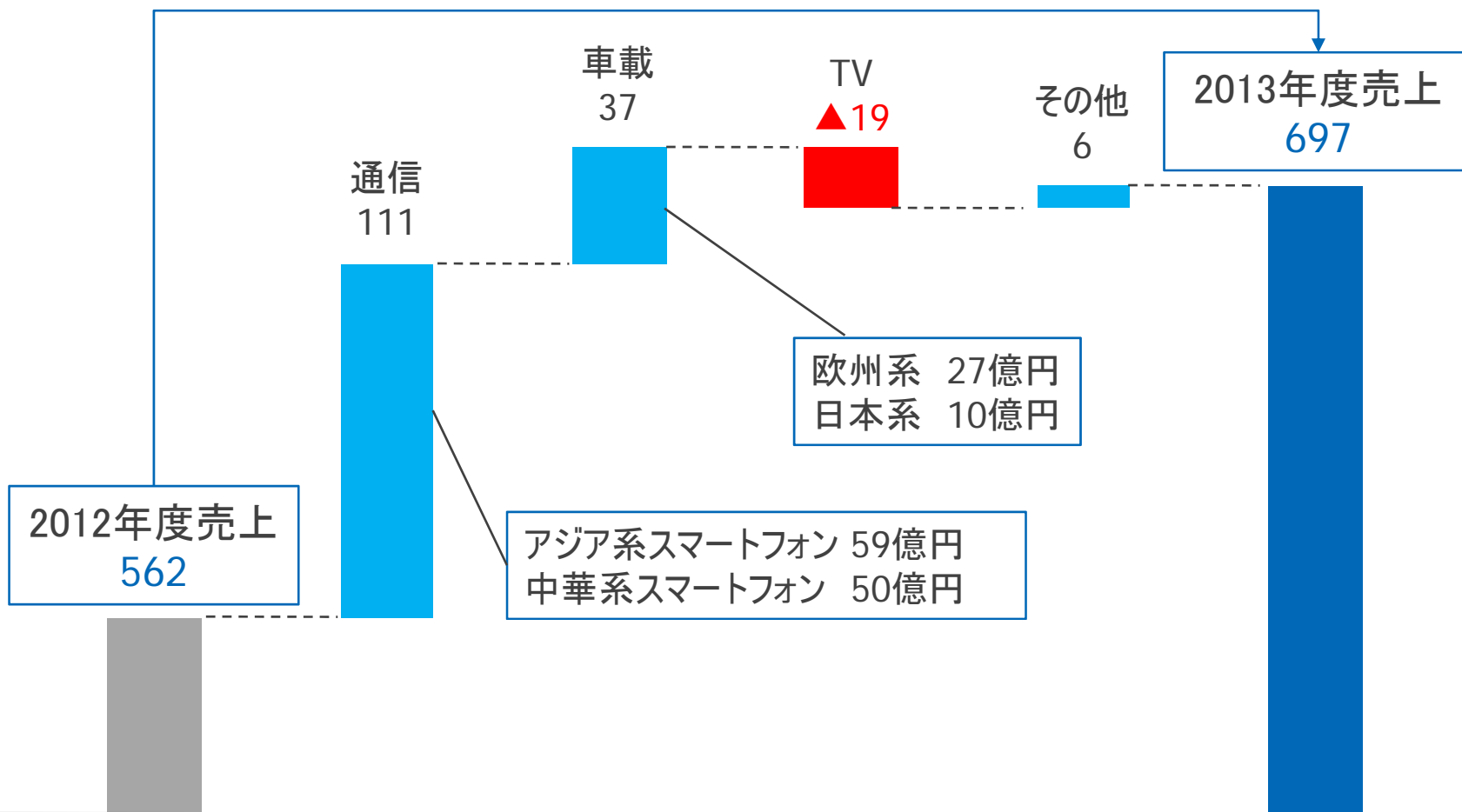
2011年度 1USD = 78.98JPY 2010年度 1USD = 85.22JPY

7. 売上計画 基板市場別 売上変動要因分析

単位: 億円

+135億円

2012年実績レート 83.31JPY
 2013年計画レート 95.00JPY
 為替による売上増 75億円



8. 2013年度経営方針

東日本大震災(3・11)より2年2ヶ月、負の連鎖より脱却し
V字回復を達成する！

■ 販売戦略

モバイル市場・車載市場を中心に積極的な拡大
SSD市場・FPC基板・放熱基板の新規開拓

■ 生産戦略

武漢工場の生産数量増による黒字確保
ベトナム工場を拡大する
石巻工場の再開

■ 技術戦略

新FPC基板及び厚銅基板の差別化工法開発、
部品内蔵・新FR基板・高多層基板の商品開発

9. 広州工場 重点施策 及び見通し

- 車載品の受注を強化、高信頼性・リードタイム短縮を実現し、世界最高の車載工場を目指す。
- 人生産性を上げ、生産量に応じた適切な人員コントロールを行う。
- 副資材・消耗品のコストダウンを推進し、高収益化を達成する。

単位：百万円

	2012年度実績	前年比	2013年度見通し	前年比
売上高	27,661	-2.5%	26,246	-5.1%
営業利益	1,570	63.5%	1,913	21.8%
営業利益率	5.7%		7.3%	

レート 1USD=83.31JPY

1USD=95.00JPY

10. 武漢工場 重点施策 及び見通し

- 第一工場はSSD基板を生産開始、車載品の受注を採り入れ、従来の主力であったTV基板からの脱却を目指す。
- 第二工場は主力をアメリカ系スマートフォンから中華系・アジア系スマートフォン向けHDI基板へと転換する。
- 人生産性を上げ、生産量に応じた適切な人員コントロールを行う。

単位：百万円

	2012年度実績	前年比	2013年度見通し	前年比
売上高	17,665	-7.1%	22,859	29.4%
営業利益	-2,638	-381.4%	250	-
営業利益率	-14.9%		1.1%	

レート 1USD=83.31JPY

1USD=95.00JPY

11. 越南工場 重点施策 及び見通し

- ハイエンドなスマートフォンを高品質・短納期で作り込む生産体制を構築する。
- FPC基板＋EMS(部品実装)の一環生産体制を生かした事業を確立する。
- 独シュヴァイツァー社との車載用協業ラインの構築を進める。
- 越南及び周辺各国の顧客を地の利を生かし積極的に開拓する。

単位：百万円

	2012年度実績	前年比	2013年度見通し	前年比
売上高	3,390	304.1%	10,273	203.0%
営業利益	-1,461	-93.0%	1,025	-
営業利益率	-43.1%		10.0%	

レート 1USD=83.31JPY

1USD=95.00JPY

12. 石巻工場

- 地域復興、地元社員の雇用、国内に最先端技術を残すことを目的に稼働を再開する。
- モジュール基板・部品内蔵基板の生産及び新厚銅基板・新FPC基板等のパイロットラインの導入
- 売上規模は初年度1.5億円程度を見込む。(震災前は売上規模50億円)
- 5/17(金)に宮城県知事・石巻市長を招き落成式を開催した。



落成式写真

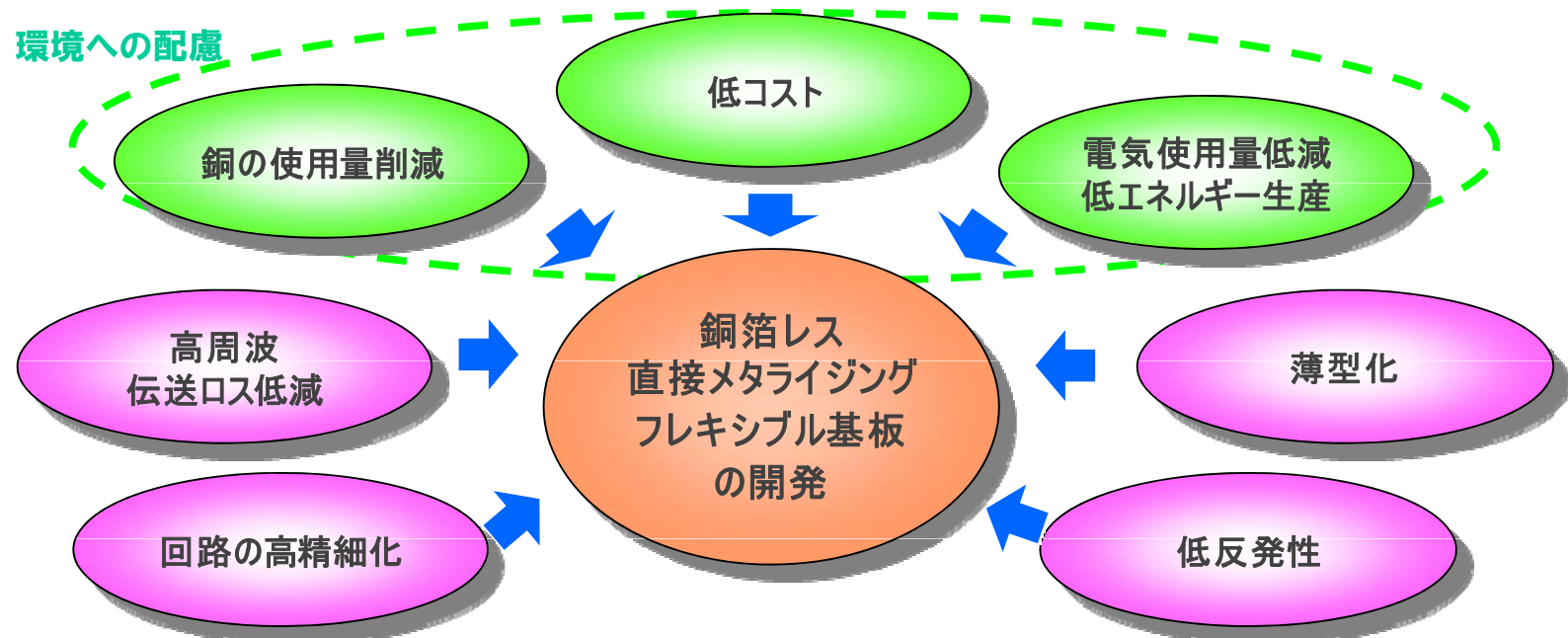
Ⅲ. 技術戦略



1. 2013年度技術戦略

- 新FPC基板の差別化工法開発
工程削減による低コスト化・高周波特性改善
- 部品内蔵の商品開発
小型化・高密度配線・高信頼性
- 新FR基板・高多層基板の商品開発
省スペース化・低コスト化
- 新放熱基板の商品開発
大電流対応

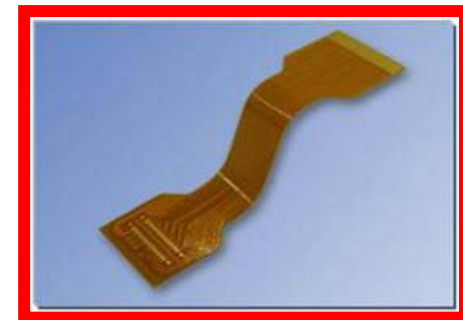
2. 新FPC基板(MDiM)の開発コンセプト



・メーカーの新Seedsで市場要求へ対応

分子接合技術を用いた新FPC基板を開発

樹脂材料表面に **直接めっき** を施す技術！



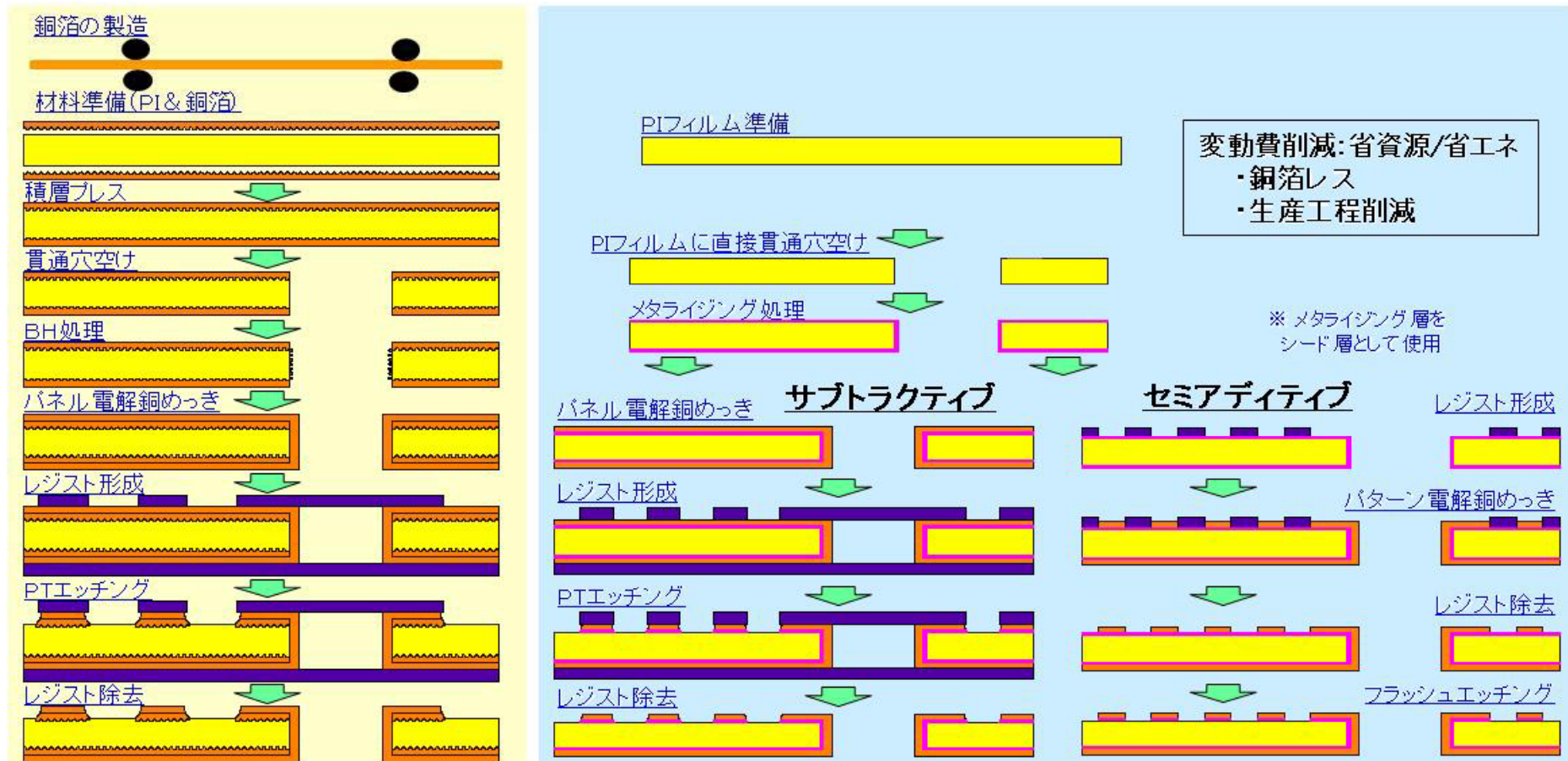
2. 従来FPC基板と新FPC (MDiM) 基板の工程差

従来FPC基板

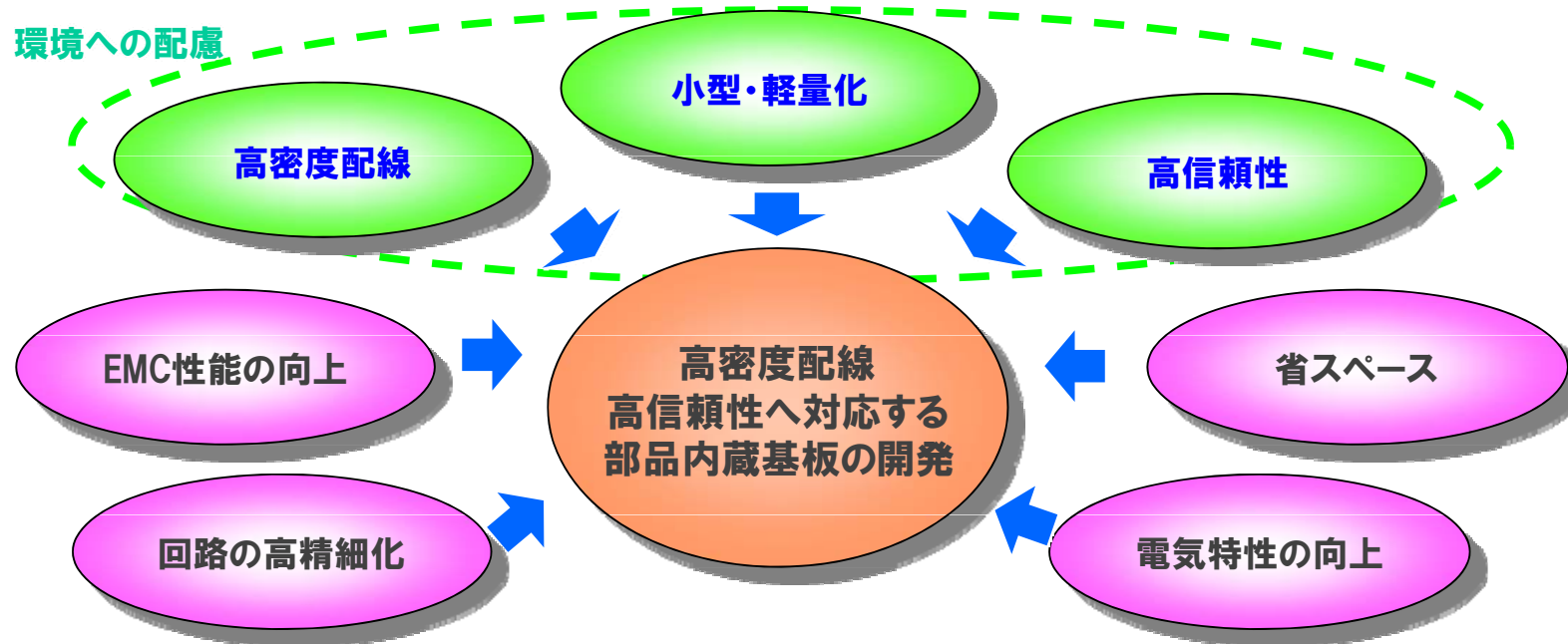
新FPC (MDiM) 基板

工程数 9

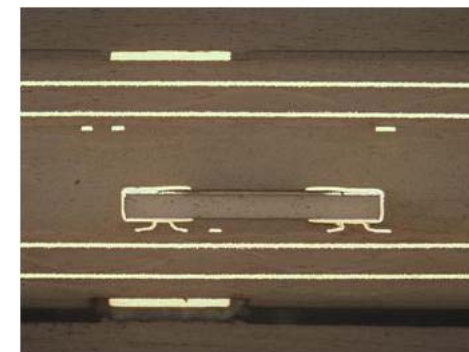
工程数 6



3. 小型化技術(部品内蔵)の開発コンセプト



断面写真



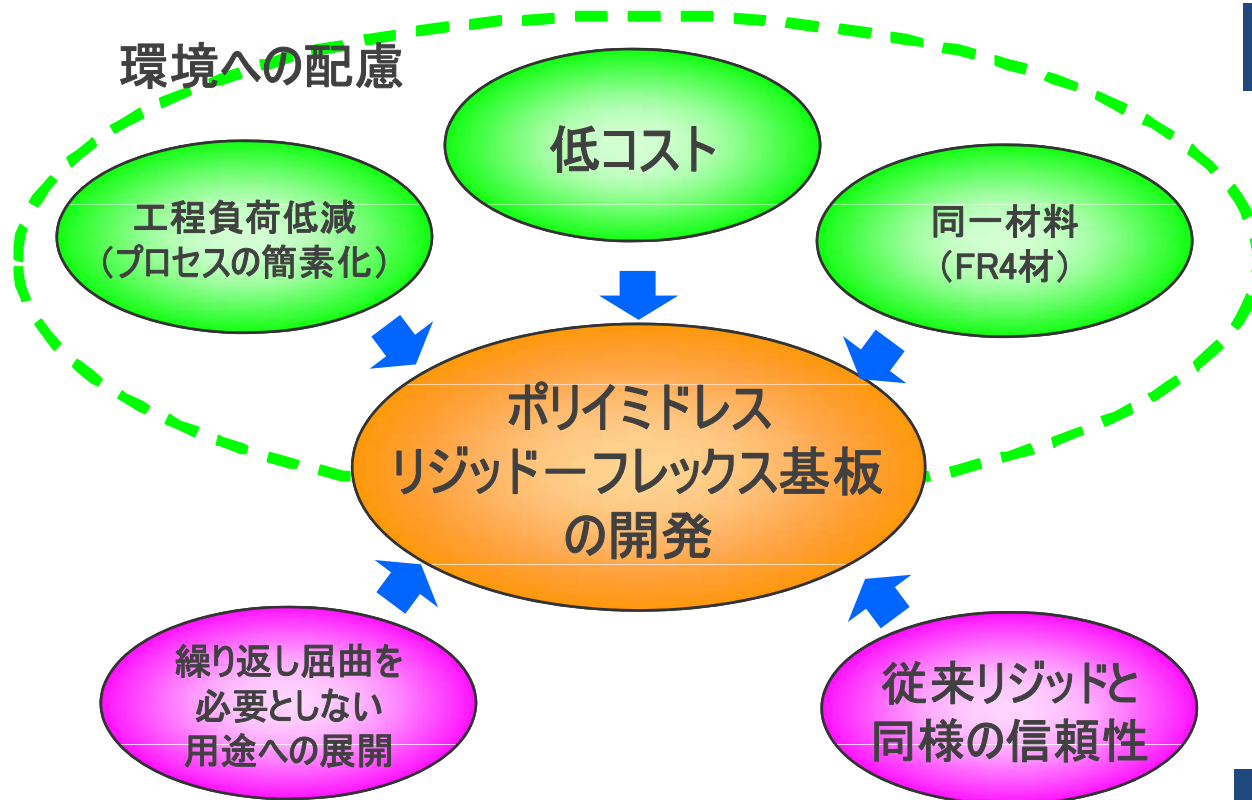
受動部品内蔵によるメリット

- ✓ メモリーチップの配置面積拡大によりメモリー容量が増大
- ✓ 電源コンデンサへの配線長短縮により電気特性が向上

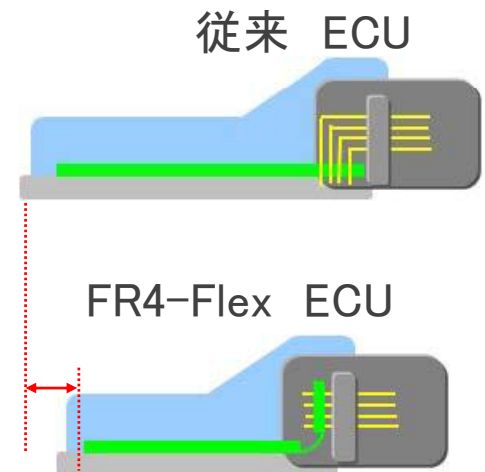
部品内蔵基板の特長

- ✓ 銅めっき接続工法により高信頼性・高密度配線を実現

4. 新FR基板のコンセプト

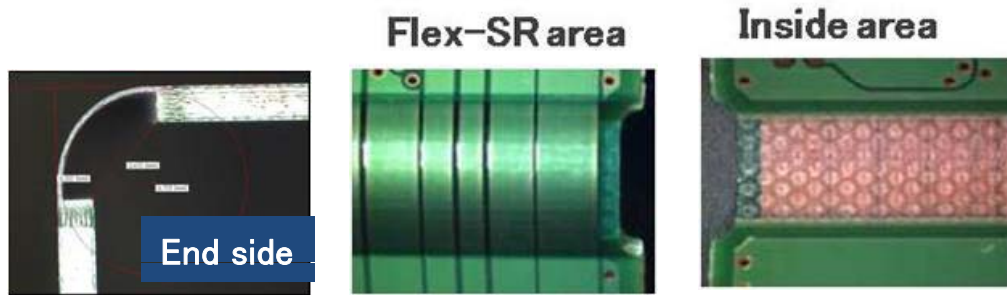


FR4 Flex 使用用途(例)



FR4 Flex 市場

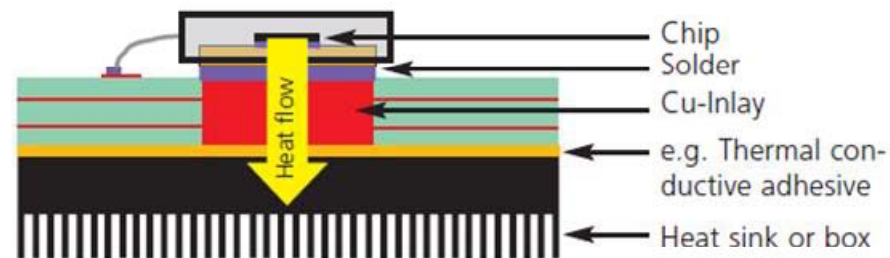
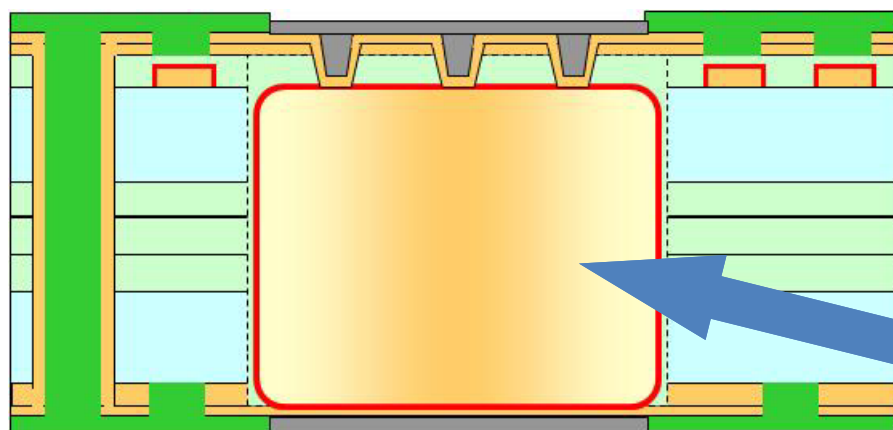
欧州車載メーカー情報では、2020年で車載向け基板PCBのうち、半分程度がFR4-Flexに置き換わると予測。



5. 新放熱基板

- ◆欧州車載向けパワー系基板(主にセラミックス)の代替に開発。
- ◆放熱及び大電流用途に使用可能。

新放熱基板 使用用途(例)



銅塊



新放熱基板 市場

- ◆欧州車載向けパワー基板で厚銅仕様の需要が急増、大きな潜在需要が見込まれる。
 - ◆駆動系基板(2015年までの伸び率: バッテリー関連 +44%、スタート/ストップ +31%)
 - ◆厚銅のポテンシャル基板: 駆動系\$100Mio/年(PCB20%、特殊基板(セラミックスなど)80%)
エンジンブレーキ\$70Mio/年(PCB50%、特殊基板(セラミックスなど)50%)
- 特殊(セラミックスなど)基板などの置換えとして、この分野でPCBのポテンシャルが大きい。



株式会社マイコー

<http://www.meiko-elec.com/>

2013年5月21日